

2026 年 09 月 17 日

鸿富诚（301716.SZ）

投资要点

◆ 9 月 10 日一家创业板上市公司“鸿富诚”询价。

◆ 鸿富诚（301716）：公司专注热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子功能材料及器件研发及产业化。公司 2023-2025 年分别实现营业收入 2.60 亿元/3.30 亿元/7.07 亿元，YOY 依次为 6.49%/26.62%/114.34%；实现归母净利润 0.35 亿元/0.71 亿元/2.69 亿元，YOY 依次为-9.24%/104.38%/276.51%。根据公司预测，2026 年 1-9 月营收同比增长 31.13%至 39.33%，归母净利润同比增长 28.67%至 40.74%。

② **投资亮点：1、公司系业内少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业，同时也是国内极少数实现 TIM1 热界面材料小批量供应的企业。**随着 AI 算力产业高速爆发，GPU 芯片功耗持续飙升，传统风冷散热方案触及物理天花板，难以满足超高算力场景稳定运行需求；2026 年，英伟达推出的新一代 Vera Rubin 算力平台已全面切换石墨烯导热垫片，取代钎焊液态金属方案作为 TIM2 热界面主材。公司是行业内少数能够量产制备石墨烯导热垫片的企业，TIM1.5/2.0 热界面材料已实现规模供应，同时也是国内极少数成功实现 TIM1 热界面材料小批量供应的企业；TIM1 热界面材料作为芯片封装内材料，直接接触发热芯片，因此对其导热性能、机械性能以及稳定性要求较 TIM1.5/2 热界面材料更为苛刻。与此同时，公司石墨烯导热垫片产品正积极向数据中心、光通信等新兴领域拓展，覆盖 AI 服务器 CPU 芯片、AI 服务器交换机、1.6T 光模块、IGBT 模块等新兴高增长、高附加值应用场景，部分前述场景预计于 2026 年进入量产阶段。**2、公司在石墨烯导热垫片基础上，进一步研制出金属碳基复合材料；2025 年金属碳基复合材料进入大规模量产，成为拉动公司近年业绩增长的重要引擎。**2024 年，公司基于石墨烯导热垫片，进一步开发出面向高功率 AI 芯片测试的金属碳基复合材料；该产品兼具低热阻、良好机械回弹性与界面稳定性，并有效解决了传统热界面材料热阻与复用性难以兼顾的行业痛点，目前主要应用于高功率 AI 芯片板卡的测试环节；2025 年，公司金属碳基复合材料实现规模化量产落地，依托下游 AI 算力需求拉动，相关收入由 2024 年的不足 50 万元大幅增长至 1.92 亿元，成为公司收入增长的重要引擎。另据问询函回复披露，公司正积极开拓金属碳基复合材料液冷板测试项目，当前处于测试验证阶段；同时由于金属碳基复合材料兼具高导热与可重复使用的特点，适配高频插拔、高速传输的核心场景（如数据中心 AI 集群、800G/1.6T 光模块，需兼顾耐插拔与导热），公司亦正推进相关客户拓展工作，有望打开新的业绩增长空间。**3、公司股东实力雄厚，华为旗下哈勃科技为前十大股东，阿里云、通富微电、新易盛等行业龙头及深圳国资背景创投机构亦参与战略配售。**据公司招股书披露，华为旗下哈勃科技持有公司 4.11%的股份，为公司第六大股东；同时本次 IPO 战略配售阵容兼具产业龙头与国资创投，包括阿里云、通富微电、新易盛、东山精密（通过旗下苏州东山产业投资有限公司）等在内的产业链龙头参与配售，深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团两家深圳国资背景创投机构亦战略入股。

② **同行业上市公司对比：**根据主营业务的相似性，选取飞荣达、中石科技、苏州天脉、隆扬电子、德邦科技、阿莱德为鸿富诚的同行业可比上市公司。从

新股覆盖研究

交易数据

总市值（百万元）	
流通市值（百万元）	
总股本（百万股）	74.92
流通股本（百万股）	
12 个月价格区间	/

分析师

李蕙

SAC 执业证书编号：S0910519100001
lihui1@huajinsc.cn

分析师

戴铮

SAC 执业证书编号：S0910526030001
daizhengzheng@huajinsc.cn

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（乔路铭）

-2026 年 78 期-总第 715 期 2026.7.14

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（龙鑫智能）-2026 年 76 期-总第 713 期 2026.7.13

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（泰诺麦博）-2026 年 77 期-总第 714 期 2026.7.10

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（欧伦电气）-2026 年 75 期-总第 712 期 2026.7.9

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（永励精密）-2026 年 73 期-总第 710 期 2026.7.4



上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 19.95 亿元，平均 PE-TTM（算术平均）为 80.57X，平均销售毛利率为 34.81%；相较而言，公司营收规模未及可比公司平均，但销售毛利率处于同业的中高位区间。

◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

公司近 3 年收入和利润情况

会计年度	2023A	2024A	2025A
主营收入(百万元)	260.4	329.7	706.7
同比增长(%)	6.49	26.62	114.34
营业利润(百万元)	39.5	82.4	316.5
同比增长(%)	-8.78	108.47	283.94
归母净利润(百万元)	35.0	71.5	269.1
同比增长(%)	-9.24	104.38	276.51
每股收益(元)	0.63	1.28	4.81

数据来源：聚源、华金证券研究所

内容目录

一、鸿富诚.....	4
（一）基本财务状况.....	4
（二）行业情况.....	5
（三）公司亮点.....	9
（四）募投项目投入.....	10
（五）同行业上市公司指标对比.....	11
（六）风险提示.....	11

图表目录

图 1：公司收入规模及增速变化.....	5
图 2：公司归母净利润及增速变化.....	5
图 3：公司销售毛利率及净利润率变化.....	5
图 4：公司 ROE 变化.....	5
图 5：2020 年至 2031E 全球热界面材料市场规模.....	6
图 6：2020 年至 2031E 中国热界面材料市场规模.....	6
图 7：全球电磁屏蔽材料市场规模（亿美元）.....	8
图 8：2016-2033E 全球吸波材料市场规模.....	9
表 1：公司 IPO 募投项目概况.....	10
表 2：同行业上市公司指标对比.....	11

一、鸿富诚

公司是一家专注热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子功能材料及器件研发、产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品主要包括导热界面材料、电磁屏蔽及吸波材料。该等材料是保障各类电子信息产品可靠性和稳定运行的关键材料，广泛应用于数据中心（AI 高功率芯片、光模块）、智能汽车、5G 通信及消费电子等领域。

在热管理领域，公司采用创新取向技术，实现石墨烯材料的垂直排列，充分挖掘石墨烯在垂直方向的优异导热性能，通过界面功能化实现极低热阻，目前公司量产产品导热系数达到 $130\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，热阻低于 $0.06^\circ\text{Ccm}^2/\text{W}$ ，可快速导出热量，同时具备优异的压缩回弹性，能够有效解决高功率大尺寸芯片翘曲形变等关键问题，消除界面空隙，长期使用无泵出风险，保障散热稳定性。凭借石墨烯导热垫片、金属碳基复合材料等创新产品，目前公司已进入全球头部 AI 芯片企业导热界面材料供应链并批量供货。随着人工智能、超算服务器等高功率芯片应用市场的快速发展，该等领域对热管理要求越来越高，高端导热界面材料已经成为制约产品性能的关键电子材料，公司产品未来市场前景广阔。

在电磁屏蔽材料领域，公司目前已经掌握电磁屏蔽材料生产所需的核心技术，形成了品类完善的产品体系，包括一些工艺难度较高的屏蔽材料，如 SMT 导电泡棉，其兼具耐高温、高回弹和自动焊接等特点，应用于汽车电子行业；半包裹导电泡棉、导电毛丝产品，其具备低应力、高回弹等特点，解决了目前电子产品屏下导电干扰及应用过程中可能出现水波纹问题，产品性能处于国内领跑水平，产品应用于各大消费电子品牌终端产品中。

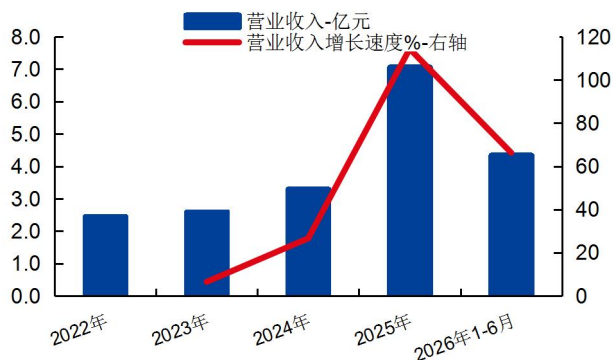
在吸波材料方面，公司基于水基功能涂料制备技术及片状取向工艺技术，可量产具有宽范围导磁性能（在 1MHz 频率下，磁导率值覆盖 50 至 300）的吸波材料，从而达到吸波材料“宽频、环保性”的目标，产品应用于各大消费电子品牌终端产品中。

（一）基本财务状况

公司 2023-2025 年分别实现营业收入 2.60 亿元/3.30 亿元/7.07 亿元，YOY 依次为 6.49%/26.62%/114.34%；实现归母净利润 0.35 亿元/0.71 亿元/2.69 亿元，YOY 依次为 -9.24%/104.38%/276.51%。据最新财报情况，2026 年 1-6 月公司实现营业收入 4.35 亿元，同比增长 66.29%；实现归属于母公司净利润 1.76 亿元，同比增长 94.60%。

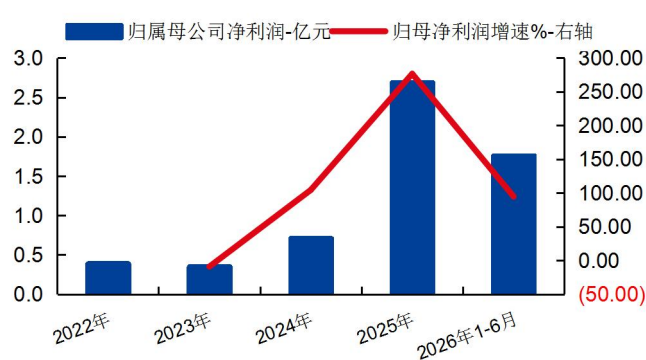
2025 年，公司主营业务收入按产品类别可分为三大板块，分别为热管理材料及器件（5.69 亿元，占 2025 年主营收入的 80.77%）、屏蔽材料（0.98 亿元，占 2025 年主营收入的 13.92%）、吸波材料（0.37 亿元，占 2025 年主营收入的 5.30%）。报告期间，公司主营业务收入主要来源于热管理材料及器件、收入占比稳定在 55%以上，且呈逐年增长态势，已由 2023 年的 55.99% 增长至 2025 年的 80.77%；而在热管理材料及器件业务当中，又以碳基导热垫片和金属碳基复合材料为主体，2025 年合计为公司贡献六成以上收入。

图 1：公司收入规模及增速变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



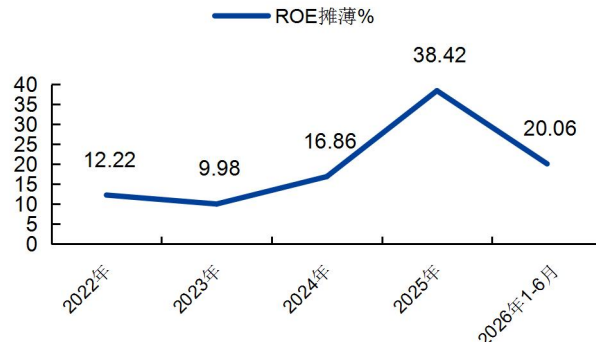
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利润率变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

（二）行业情况

1、热管理材料行业

导热界面材料（Thermal Interface Materials, TIM）亦称热界面材料，是一种广泛应用于集成电路封装和电子散热的材料。在系统结构中，两种异质材料的接触界面或结合界面会产生微空隙、界面表面会有凹凸不平的孔洞等缺陷，热界面材料可以填充这些空隙及孔洞，减小传热的接触热阻，使电子元件产生的热量能更快速地通过热界面材料传递到散热器，达到降低工作温度、延长使用寿命的重要作用。

当前热界面材料种类较多，不同类型的导热界面材料特征及应用场景各不相同。市场上常见热界面材料主要分为高分子基复合材料、金属基热界面材料及处于前沿探索阶段的新型热界面材料。高分子基复合材料包括导热硅脂、导热凝胶、导热胶、导热垫片及导热相变材料等；金属基热界面材料以低熔点焊料、液态金属材料等为代表；新型的热界面材料则以导热高分子、石墨烯和碳纳米管阵列等为代表。其中，石墨烯是一种典型的二维材料，单层的石墨烯厚度仅为 0.335nm，由于其具有特殊的晶体结构与电子分布方式，因此具有十分出色的机械性能、极高的载流子迁移率、优异的导热性能以及透光率，在导热界面材料领域具有极大的潜力；导热性能方面，采用非

接触共焦拉曼测试的单层悬空石墨烯的水平方向热导率高达 $5,300\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，明显高于金刚石和单壁碳纳米管；对于含缺陷和官能团的石墨烯粉体而言，随着制备方法的不同，其导热系数也会略有差别，导热率的分布范围为 $800\text{-}3,500\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，但也远高于铜、铝等金属以及氮化铝、碳化硅等陶瓷材料。

近年来，受益于 AI、5G、新能源汽车、消费电子等下游领域的快速发展，热界面材料的市场规模呈稳步增长态势。根据 QY Research 数据显示，2024 年全球 TIM 市场销售额已达 20.12 亿美元，预计到 2031 年将增长至 41.48 亿美元，2025 至 2031 年间年复合增长率达 10.74%。

图 5：2020 年至 2031E 全球热界面材料市场规模



资料来源：QY Research，华金证券研究所

在国内市场，随着 5G 的商用化，电子材料国产化进程加速以及导热散热材料在新能源汽车、动力电池、数据中心等应用领域的持续拓展，我国热界面材料市场规模持续增长，2024 年中国市场规模达到 10.27 亿美元，预计 2031 年将达到 21.64 亿美元，年复合增长率预计为 11.09%。

图 6：2020 年至 2031E 中国热界面材料市场规模



资料来源：智研咨询，华金证券研究所

未来随着“AI+”浪潮的到来将持续拉动电子器件散热需求，尤其在数据中心及 ADAS、消费电子、电动汽车等领域。

（1）数据中心和汽车 ADAS 应用领域

数据中心方面，随着数据中心由“智能”向“智算”迈进，市场投入持续高速增长。据中国数据中心研究，全球数据中心产业规模在 2022 年达到 1,308 亿美元，总体逐步进入成熟期。2022 年生成式人工智能大模型推向市场，在国内引起 AIGC 发展热潮，大模型训练对智能算力的需求迅速攀升。传统的数据中心概念扩展升级为智算中心，包含算力（AI 服务器）、存储+网络设备、基础设施（机房、风火水电等）和算法（软件平台、数据服务）。2023 年中国智算中心市场投资规模达 879 亿元，同比增长 90% 以上。未来，AI 大模型应用场景不断丰富，商用进程加快，智算中心市场增长由训练切换至推理，预计 2028 年中国智算中心市场投资规模有望达到 2,886 亿元。在人工智能、云计算、电信和加密货币的推动下，数据中心的功能越来越强大，密度越来越高，对高端导热散热材料的需求愈加迫切。

在 ADAS 中，传感器、摄像头和处理器等各种电子器件用于收集和处理数据，并做出决策。这些组件在运行过程中会产生热量，随着设计的不断密集化，散热将成为一个更大的挑战。如果热管理不当，就会影响计算性能，甚至对器件造成损坏，从而引发重大技术和安全问题。预计到 2033 年，ADAS 传感器和 ECU 的 TIM 市场将达到 6 亿美元。

对于数据中心和 ADAS，ID TechEx 认为，高性能 TIM 有望越来越多地被用于处理快速增长的功率密度，高性能 TIM 也意味着高单价，从而推动热界面收入规模的快速增长。据 ID TechEx 预测，从 2022 年到 2034 年，ADAS 和数据中心的 TIM 市场规模将分别增长 9 倍和 18 倍。

（2）消费电子端应用领域

2024 年智能手机市场回暖明显，2025 年中国智能手机市场出货量将继续稳步增长。全球智能手机市场在 2024 年扭转连续两年下滑态势，出货量增长 7%，达 12.2 亿部，2025 年有望延续。结构上，各大品牌纷纷加强对于端侧 AI 技术的深度融合和创新，AI 手机市场开启新增长。据 IDC 预测，2024 年全球 AI 手机出货量将达 2.34 亿部，同比增长 368%，到 2025 年，生成式人工智能手机的出货量预计同比增长 73.1%；到 2028 年，生成式人工智能手机的出货量将达 9.12 亿部，2024 年-2028 年的年复合增长率将为 78.4%。

目前对于 AI 终端的散热设计方法处于多元化发展阶段，散热技术与材料介质繁多，可以通过多种导热材料、零部件组合，实现对 AI 终端的高效散热。以智能手机为例，以石墨膜等散热材料和 VC 均热板为主的散热设计系统逐渐成为主流趋势。

（3）电动汽车应用领域

新能源汽车的不同部件需要不同的 TIM 产品，例如导热耗散间隙填料、导热胶、导热片、导热膏等，这些产品的导热系数范围从 1W/m·K 到 6.5W/m·K，可以满足不同部件对导热产品的性能要求。在新能源汽车三电系统中，导热胶粘剂是电池部件导热的关键材料，胶粘剂广泛应用于 PACK 密封、结构粘接、结构导热、电池灌封等方面，提供安全防护、轻量化设计、热管理等功能。在电动汽车电控系统方面，目前电控模组主要以 IGBT 模组与冷面之间的刚性界面涂抹导热硅脂为主要方式，减少热阻隔。随着电控系统从 SiIGBT 过渡到 SiC MOSFET，这种趋势对高性能 TIM 和芯片连接材料的需求有望不断提高。另外，电机系统则应用高导热胶对驱动电机内产生旋转磁性的定子进行整体灌封。而在电动车配套的充电桩方面，高导热界面材料引入也非常普遍，例如，导热硅胶垫片用于电感模块导热，导热硅脂用于芯片导热、导热硅胶用于电源灌封等。

随着电动汽车的日益普及，TIM 市场需求也在迅速增长，预计这一趋势在未来十年内仍将持续。根据中国汽车工程学会、工信部编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，到 2035 年，我国新能源汽车占汽车总销量的比例预计将达到 50% 以上，新能源汽车领域潜在增长空间广阔。

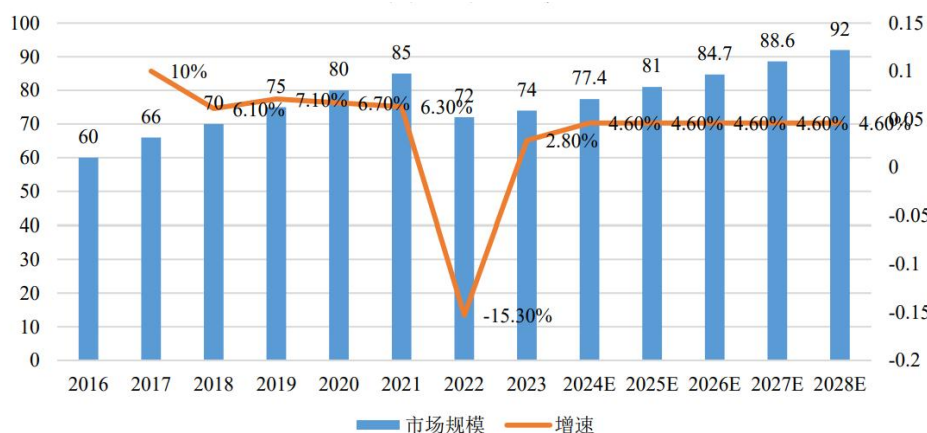
2、电磁屏蔽材料行业

电磁屏蔽材料是电子产品的必备材料之一，其通过反射、吸收或多重损耗机制阻断电磁波传播，防止电子设备间的相互干扰。在电子设备工作时，既不希望被外界电磁波干扰，又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备及对人体的辐射危害，这就需通过电磁屏蔽来阻断电磁波的传播路径。电磁屏蔽材料可通过反射或者吸收电磁波的方式阻断电磁波的传播路径，减小电磁波产生的影响，从而实现电磁屏蔽功能。

当前，电磁屏蔽材料在电子数码产品、无线充电、RFID 射频识别、移动通信设备、柔性电路板、高速 CPU 芯片、图像处理器、储存芯片、屏蔽罩内壳、高速微处理器等众多领域得到广泛应用。随着手机、电脑等电子产品日渐小型化，内部集成度不断提高，电子设备之间的电磁干扰亦日益明显，电磁屏蔽材料在电子产品中占据着重要地位，且在 5G/6G 通信、人工智能、新能源汽车等领域快速发展带动下，电磁屏蔽材料在现代电子技术中的重要性日益增加。

近年来，随着技术的发展和电子产品的升级换代，电子产品向轻量化、精密化方向发展，内部电子元器件日益增加，内部结构愈发紧密，而电磁干扰问题成为影响电子产品性能的关键因素，促使电磁屏蔽材料市场需求持续稳步增长。根据 BCC Research 数据显示，全球电磁屏蔽材料市场规模由 2016 年的 60 亿美元增至 2023 年的 74 亿美元，期间年复合增速达 3.04%，预计至 2028 年市场规模将达 92 亿美元，呈持续增长态势。

图 7：全球电磁屏蔽材料市场规模（亿美元）



资料来源：BCC Research，华金证券研究所

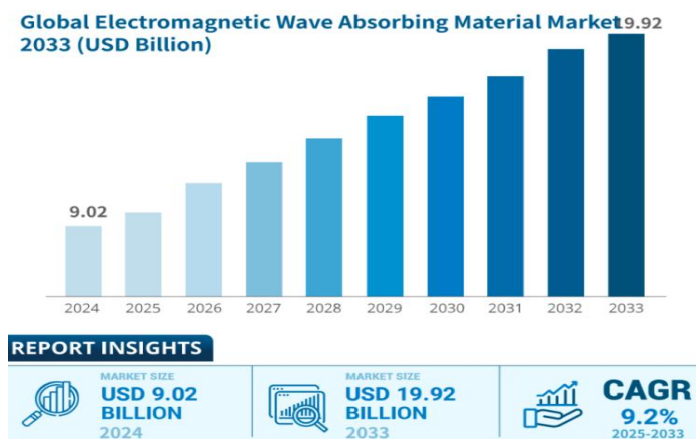
3、吸波材料行业

吸波材料指可吸收、衰减空间入射的电磁波能量，抑制反射电磁波的一类功能材料，并将电磁波能量转化成为热能或其他形式能量，从而显著降低电磁波反射和透射的特殊功能材料，其主要作用是降低电磁波的干扰和反射，在通信、电子设备、电磁兼容（EMC）、5G 通信、汽车雷达、卫星通信、精密仪器等多个领域得到广泛应用。

吸波材料按照损耗机制可以分为电阻损耗型、电介质损耗型、磁损耗型。随着科技的发展，吸波材料正向轻量化、高效宽频、环境适应性强、可定制化等方向发展，以满足国防安全、航空航天、新能源汽车、5G 通信和物联网等行业对电磁波吸收和电磁兼容性能的更高要求。

全球吸波材料市场规模近年来保持稳定增长。根据 Business Research Insights 市场研究机构的统计数据，2024 年全球电磁波吸收材料市场规模约为 90.2 亿美元，预计到 2033 年将达到 199.2 亿美元，在预测期内的复合年增长率约为 9.2%。其中，亚太地区是全球吸波材料市场增长最快的区域，尤其是在中国，受益于 5G 通信、智能汽车、国防军工等行业的快速发展，吸波材料市场规模预计在未来几年将继续保持高速增长。

图 8：2016-2033E 全球吸波材料市场规模



资料来源：Business Research Insights，华金证券研究所

（三）公司亮点

1、公司系业内少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业，同时也是国内极少数实现 TIM1 热界面材料小批量供应的企业。随着 AI 算力产业高速爆发，GPU 芯片功耗持续飙升，传统风冷散热方案触及物理天花板，难以满足超高算力场景稳定运行需求；2026 年，英伟达推出的新一代 Vera Rubin 算力平台已全面切换石墨烯导热垫片，取代铟镓液态金属方案作为 TIM2 热界面主材。公司深耕热界面材料领域，现阶段产品已逐步由传统高分子基复合材料向石墨烯等高性能、高附加值的新型热界面材料迭代升级，是行业内少数能够量产制备石墨烯导热垫片的企业，TIM1.5/2.0 热界面材料已实现规模供应，同时也是国内极少数成功实现 TIM1 热界面材料小批量供应的企业；据招股书披露，TIM1 热界面材料作为芯片封装内材料，直接接触发热芯片，因此对其导热性能、机械性能以及稳定性要求较 TIM1.5/2 热界面材料更为苛刻。与此同时，公司石墨烯导热垫片产品正积极向数据中心、光通信等新兴领域拓展，覆盖 AI 服务器 CPU 芯片、AI 服务器交换机、1.6T 光模块、IGBT 模块等高热流密度、新兴高增长赛道及高附加值应用场景，部分前述场景预计于 2026 年进入量产阶段。

2、公司在石墨烯导热垫片基础上，进一步研制出金属碳基复合材料；2025 年金属碳基复合材料进入大规模量产，成为拉动公司近年业绩增长的重要引擎。2024 年，公司基于石墨烯导热垫片，进一步开发出面向高功率 AI 芯片测试的金属碳基复合材料；该产品兼具低热阻、良好

机械回弹性与界面稳定性，可用于重复测试，有效解决了传统热界面材料热阻与复用性难以兼顾的行业痛点，目前主要应用于高功率 AI 芯片板卡的测试环节；2025 年，公司金属碳基复合材料实现规模化量产落地，依托下游 AI 算力需求拉动，相关收入由 2024 年的不足 50 万元大幅增长至 1.92 亿元，成为公司收入增长的重要引擎。另据问询函回复披露，公司正积极开拓金属碳基复合材料液冷板测试项目，目前处于测试验证阶段；同时由于金属碳基复合材料兼具高导热与可重复使用的特点，适配高频插拔、高速传输的核心场景（如数据中心 AI 集群、800G/1.6T 光模块，需兼顾耐插拔与导热），公司亦正推进相关客户拓展工作，有望打开新的业绩增长空间。

3、公司股东实力雄厚，华为旗下哈勃科技为前十大股东，阿里云、通富微电、新易盛等行业龙头及深圳国资背景创投机构亦参与战略配售。据公司招股书披露，华为旗下哈勃科技持有公司 4.11% 的股份，为公司第六大股东；同时本次 IPO 战略配售阵容兼具产业龙头与国资创投，包括阿里云、通富微电、新易盛、东山精密（通过旗下苏州东山产业投资有限公司）等在内的产业链龙头作为具备业务战略合作关系、长期协同愿景的企业参与配售，深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团两家深圳国资背景创投机构亦战略入股，或有望为公司业务拓展、技术研发等方面提供多维资源支持。

（四）募投资项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 3 个项目，以及补充流动资金、发展与科技储备资金。

1、先进电子功能材料基地建设项目：项目拟用于租赁及购置生产厂房，新增导热界面材料、电磁屏蔽材料先进生产线。项目建成后，将提升公司导热界面、电磁屏蔽等材料的产能规模。根据公司预测，项目达产后将实现年销售收入 6.55 亿元，年净利润 1.07 亿元。

2、深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目：项目通过购置先进研发测试设备以及相关软件系统、引进专业研发人才等，开展高性能碳基导热垫片、高导热高回弹绝缘垫片、高导热高挤出凝胶、高性能液态金属片等相关课题研究，提升公司的整体研发实力。

3、营销服务网络及总部基地建设项目：项目通过设立国内外区域营销中心，打造全球化的营销服务网络及专业化的营销团队，建立健全公司的营销服务体系，以固定的营销网点和人员，提高公司的营销推广和本地化服务能力，完善公司营销服务布局。与此同时，项目还将购置场地进一步扩大总部办公面积，优化总部形象。

表 1：公司 IPO 募投资项目概况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)	项目投资期
1	先进电子功能材料基地建设项目	34,043.20	34,043.20	24 个月
2	深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目	22,989.98	22,989.98	24 个月
3	营销服务网络及总部基地建设项目	10,006.00	10,006.00	24 个月
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	-
5	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00	-
	总计	122,039.18	122,039.18	-

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

（五）同行业上市公司指标对比

2025 年度，公司实现营业收入 7.07 亿元，同比增长 114.34%；实现归属于母公司净利润 2.69 亿元，同比增长 276.51%。根据管理层初步预测，公司预计 2026 年 1-9 月实现营业收入 6.40 亿元至 6.80 亿元，较 2025 年同期增长 31.13%至 39.33%；预计实现归母净利润 2.45 亿元至 2.68 亿元，较 2025 年同期增长 28.67%至 40.74%；预计实现扣非归母净利润 2.43 亿元至 2.65 亿元，较 2025 年同期增长 30.68%至 42.51%。

公司专注于热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子功能材料及器件领域；根据主营业务的相似性，选取飞荣达、中石科技、苏州天脉、隆扬电子、德邦科技、阿莱德为鸿富诚的同行业可比上市公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 19.95 亿元，平均 PE-TTM（剔除异常值/算术平均）为 80.05X，平均销售毛利率为 34.81%；相较而言，公司营收规模未及可比公司平均，但销售毛利率处于同业的中高位区间。

表 2：同行业上市公司指标对比

代码	简称	总市值 (亿元)	PE-TTM	2025 年营业收入 (亿元)	2025 年 营收增速	2025 年归 母净利润 (亿元)	2025 年归 母净利润 增速	2025 年 销售毛利 率	2025 年 ROE (摊 薄)
300602.SZ	飞荣达	225.49	49.99	65.27	24.74%	3.65	59.97%	19.47%	9.17%
300684.SZ	中石科技	280.91	79.11	18.35	17.14%	3.39	68.12%	36.26%	16.06%
301626.SZ	苏州天脉	376.19	474.01	11.17	18.50%	1.55	-16.57%	37.13%	10.01%
301389.SZ	隆扬电子	168.80	186.24	5.04	75.12%	1.04	26.20%	50.65%	4.67%
688035.SH	德邦科技	109.03	83.81	15.47	32.61%	1.08	10.45%	27.50%	4.66%
301419.SZ	阿莱德	63.53	107.27	4.37	24.41%	0.64	38.91%	37.87%	6.67%
	平均值	203.99	80.05	19.95	32.09%	1.89	31.18%	34.81%	8.54%
301716.SZ	鸿富诚	/	/	7.07	114.34%	2.69	276.51%	65.56%	47.87%

资料来源：iFind（数据截至日期：2026 年 9 月 17 日），华金证券研究所

备注：PE-TTM 计算剔除苏州天脉、隆扬电子及阿莱德。

（六）风险提示

研发投入未取得预期效果的风险、核心技术被追赶或超越的风险、产品价格下降的风险、原材料供应风险、产品质量风险、客户集中度风险、业绩短期增速放缓或业绩下滑风险、订单取消或变更及订单减少的风险、行业技术迭代风险、贸易争端风险、关税政策变动风险、市场竞争加剧的风险、毛利率下降的风险、应收账款回收的风险、汇率波动风险、实际控制人不当控制的风险等。

投资评级说明

公司投资评级：

买入 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

李蕙、戴箴箴声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址： www.huajinsc.cn